

芯片封装用的柔软硅凝胶 粘性好的有机硅凝胶材料

产品名称	芯片封装用的柔软硅凝胶 粘性好的有机硅凝胶材料
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	55.00/件
规格参数	型号:GC-94 用途:芯片封装 灌封 阻燃级别:94V0
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

芯片封装用的柔软硅凝胶 粘性好的有机硅凝胶材料

本产品属于高分子有机硅材料，由AB两组分混合硫化成型，柔软度可达到-40度，纯度高，弹性较强，硫化后为半凝固状态，作用于多种密封性基本材料，有良好的密封性，柔软度较好，可以减少或消除产品内部应力作用；耐高低温在-50 -220 可保持良好的性能，有机硅凝胶与常规液体灌封硅胶稍有不同，硅凝胶不会出现固化块状态，硫化后形成柔软有弹性的凝胶状，硫化过程中无其他反应变化！常见应用于医疗设备，由于它具有零度以下的柔软性能并且具备自动愈合条件，可长期接触皮肤内部以及人体体内。也可用于透明度及复原要求较高的高压电源模块、芯片封装、线路板的灌封保护等。

芯片灌封用的柔软硅凝胶特点：

1、硫化时无低分子放出，线膨胀系数小，缩水率低于0.1%、无腐蚀性；2、有机硅凝胶过滤器灌封硅胶和铝材，镀锌板，不锈钢等有良好的粘接性。

3、高透明材质，可检修和观察内部元件，且凝胶状容易拆卸；

4、有防水、防潮、耐老化、耐机械冲击和抗震、高绝缘强度（20MV/m）的优良性能；

5、有机硅凝粘度很低，基本和水无差异，流动性很好，可在电子产品内深度硫化；

6、具有良好的阻燃性能，可达UL94V0阻燃级；

7、硫化后的灌封凝胶具有自粘性、可自愈合性，可修复性，能够节省成本；

芯片灌封用的柔软硅凝胶性能参数：

产品特性

单位

数值

产品特性

单位

数值

诱点率

KHz

3.75

介电常数

KHz

3.8 ~ 4.2

线收缩率

%

0.3

锥入度

邵氏A

-40

耐水性

d

3

耐湿

90-110

耐油性

体积电阻

25 ohm-cm

1.35×10^{15}

耐湿热性

h

120

表面电阻

25 ohm

1.2×10^{14}

耐冻融循环

次

15

耐电压

25 kv/mm

16 ~ 18

混合粘度

cps

< 1000

阻燃级别

/

94V0

操作时间

Min

60-90

初步硫化时间

h

3-4

与金属、镀锌基材、PVC、PCB具备良好的附着力（环保无腐蚀）

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

硅凝胶运用方法：将双组份AB胶按1:1比例电子秤称重后，混合搅拌均匀（充分均匀能让硅胶发挥更好的性能），注入产品中（可手工操作也可用硅胶机械AB管注入）等待产品固化后（可室温固化也可以加热固化）建议等待24小时后再使用产品。注：如有需要添加颜色，需添加至B胶中，摇匀后，再将AB胶混合均匀。（应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80~100℃下固化20分钟，室温条件下一般需8小时左右固化。）

售后服务：

我司承诺，如因硅胶质量问题，三个月内无条件退换货；可以免费提供教学视频，在使用硅胶过程中，如有任何技术问题，都可以与我们随时联系，免费提供技术支持，新产品的研发。

芯片封装用的柔软硅凝胶 粘性好的有机硅凝胶材料